

## ヘンケルエイブルスティックジャパン株式会社

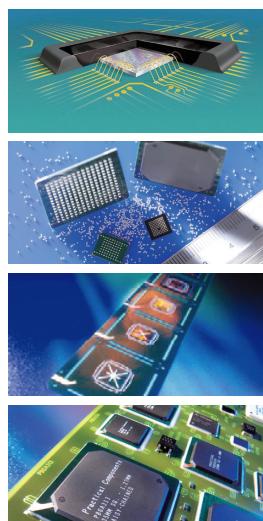
マイクロエレクトロニクスの宇宙を、より良く、豊かにするために、私たちの挑戦は限りなく続きます。

ヘンケルエイブルスティックジャパン株式会社は、前身である日本エイブルスティック株式会社より、マイクロエレクトロニクス用接着剤、封止剤の専門メーカーとして、長年にわたりグローバルに事業を展開してきました。2009年9月より、半導体/パッケージ用接着剤を扱うセミコンダクター事業部門と電子部品・回路用接着封止剤を扱うアッセンブリー事業部門は1つに統合されエレクトロニクス事業部となり、産業界のより専門的なニーズにお応えすべく、新たなソリューションを提供し続けています。

### ■ 製品カテゴリー

#### | 半導体/パッケージ用接着製品

1961年に発足した ABLESTIK Laboratories を源流とする製品群は、半導体パッケージ用接着剤を中心に、世界最大級の規模と実績を誇り、グローバルな供給体制を維持しています。世界に先駆けて開発した導電性・絶縁性に優れた一液性無溶剤型のエポキシ接着剤をはじめ、画期的なフィルム状接着剤を開発し、さらに実用性の高い一液性低温硬化型の導電性ポリイミド接着剤を提供するなど、数々の成功をおさめ、マイクロエレクトロニクス業界の発展に大きく貢献しています。



#### 【主要取扱い製品】

一液性無溶剤型エポキシ接着剤  
一次実装用アンダーフィルム

シート状接着剤  
ダイアタッチフィルム

#### | 電子部品・回路用接着封止剤製品

1948年に発足した Emerson & Cuming を源流とする製品群は、50年以上にわたり接着剤および封止剤のトップメーカーとして、電気電子部品および回路用途における広範囲なニーズに応えてきました。

①ユーザー要求を出発点とする製品の開発等、徹底した顧客満足の追求、②アメリカ・ヨーロッパおよび日本の三極での開発による常に業界トップの製品を供給できる体制、③通信ネットワーク、携帯電話、コンピューター、自動車その他各種電子部品等幅広い分野に対応できる豊富な製品群、の3点に力を注ぎ、お客様より高い評価と信頼を得ています。



#### 【主要取扱い製品】

フリップチップ/CSP/BGA 用アンダーフィル封止剤

表面実装用ダイアタッチ接着剤

封止剤

ハンダ代替用一液導電性接着剤

紫外線硬化型シール / 接着剤



## ■会社概要

商号	ヘンケルエイブルスティックジャパン株式会社（英語表記）Henkel Ablestik Japan Ltd.	
代表取締役社長	浅岡 聖二	
事業内容	電気および電子工業用部品、中間組立品、装置、機械器具および試験装置用の工業用接着剤、封止剤、被膜剤、シーリング剤、ガスケット剤および回路用インク剤ならびにこれらの原料の製造、販売および輸出入	
社員数	29名（2023年3月現在）	
資本金	1億100万円	
事業年度	1月1日～12月31日	
沿革	<p>1984 日本エイブルスティック株式会社設立</p> <p>1989 神奈川県横浜市緑区白山に本社・工場を移転</p> <p>1997 NSC社(米国)がグレース社(米国)からスペシャリティポリマー事業を買収、エマーソン&amp;カミングを日本エイブルスティック株式会社の一部門とする ICI社(イギリス)がNSC社を買収</p> <p>1999 神奈川県厚木市金田に本社およびR&amp;Dを移転 神奈川県横浜市新横浜にセミコンダクター事業部門営業部を移転</p> <p>2000 神奈川県厚木市金田に工場を移転</p> <p>2008 アクゾノーベル社(オランダ)がICI社を買収 ヘンケル社(ドイツ)がアクゾノーベル社からNSC社の接着剤および電子材料事業を買収 日本エイブルスティック株式会社は、ヘンケルグループの一員となる 営業部とマーケティング部を横浜市磯子区の横浜本社／アジアパシフィック技術センター内に移転</p> <p>2009 開発および技術サービス部を横浜本社／アジアパシフィック技術センター内に移転 社名をヘンケルエイブルスティックジャパン株式会社に変更</p> <p>2010 厚木の製造部を磯子区の横浜本社に移転</p>	

## ■主要拠点

事務所所在地	(神奈川)	〒235-0017 神奈川県横浜市磯子区新磯子町27-7	TEL: 045-758-1800
工場所在地	(加古川)	〒675-0011 兵庫県加古川市野口町北野825	TEL: 079-426-2188
	(神奈川)	〒235-0017 神奈川県横浜市磯子区新磯子町27-7	TEL: 045-758-1800